

Peningkatan kualitas pada proses marking tembaga = Quality improvement in copper marking process

Ferdian Hermawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20250216&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pada proses marking tembaga dan mencari akar permasalahan serta solusi untuk mengatasi reject part tembaga pada proses marking. Tahapan metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tahapan metode Six Sigma yaitu DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Didalam upaya peningkatan kualitas menggunakan tahapan DMAIC pada proses marking tembaga dilakukan perbaikan dengan menggunakan Jig marking, dimana improvement ini dapat menaikkan level kemampuan proses (C_p dan C_{pk}) menjadi lebih baik dari level $C_p = 0.61$ menjadi $C_p = 1.14$, dan $C_{pk} = 0.59$ menjadi $C_{pk} = 1.07$.

.....The Purpose of this project is to improve the quality of the marking process of copper. And find the root causes and solutions from reject parts of copper in the process of marking. Stages of the method used in this final project using the method stages of Six Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). In efforts to improve the quality of the DMAIC phases using the marking process is improved copper by using Jig marking, where this improvement can increase the level of process capability (C_p and C_{pk}) to be better. Than the level of $C_p = 0.61$ to be $C_p=1.14$, and $C_{pk} = 0.59$ to be 1.07.